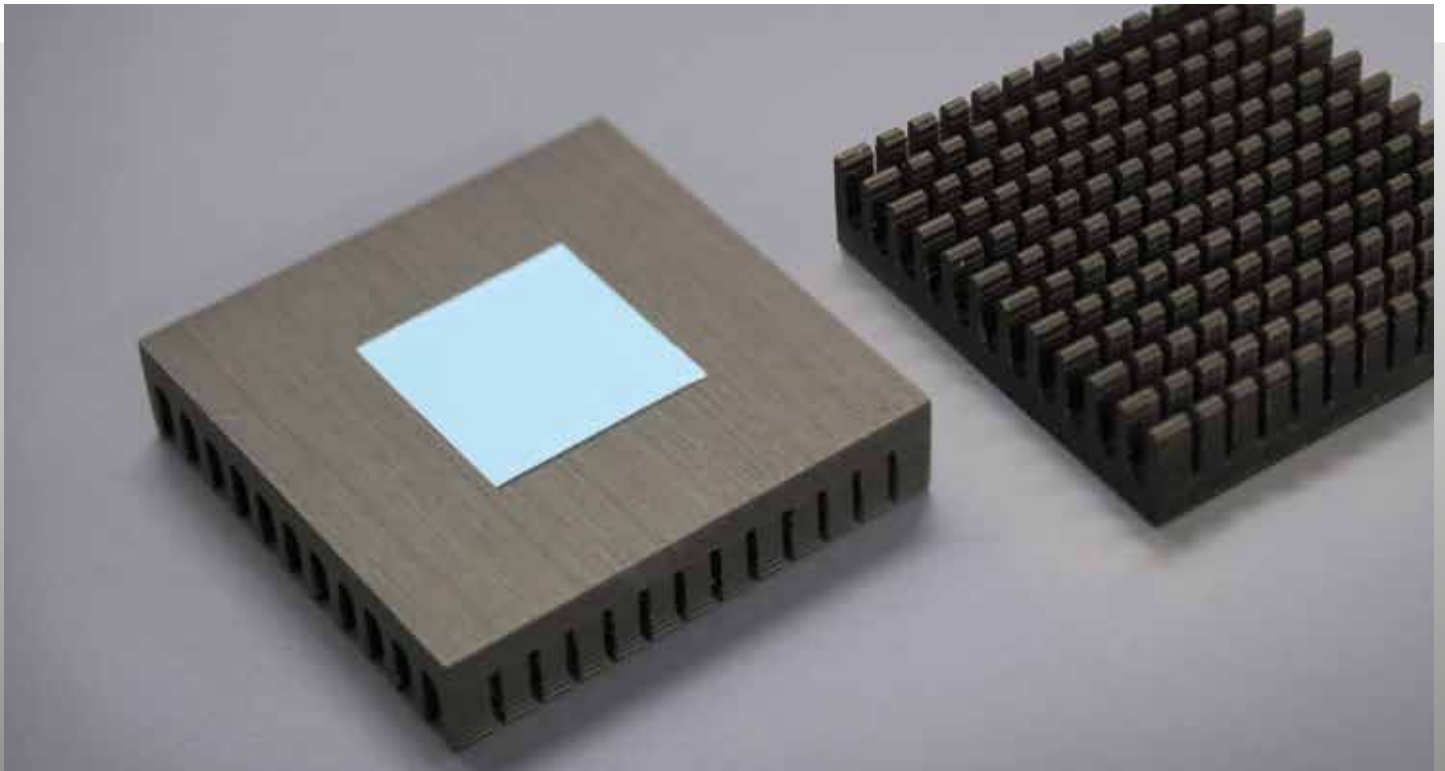


Wärmemanagement: wärmeleitende Klebstofffilme und Gap-Filler



Wärmeleitende Materialien

Elektronische Bauteile erzeugen Wärme, die durch Kühlkörper oder Kühlgehäuse abgegeben werden soll. Dadurch steigt die Leistung, wie auch die Lebensdauer der elektronischen Komponenten.

Thermisch leitfähige Klebstofffilme ermöglichen nicht nur eine effiziente Wärmeableitung vom Bauteil zum Kühlkörper, sondern bilden gleichzeitig eine mechanische Verbindung. Sie sind in verschiedenen Stärken und Materialien erhältlich.

Gap-Filler aus wärmeleitendem Material überbrücken Spaltmaße bis zu 10 Millimeter und lassen sich auch nach langer Anwendungsdauer restlos entfernen. Sie passen sich problemlos an den Bauraum an und füllen so Fugen oder unebene Klebeflächen auf.

Beide Varianten sind als Bogenware oder Formstanzteile erhältlich. Auch silikonfreie Lösungen finden sich in unserem Sortiment. Sie sind dauerhaft bis 100°C bzw. 180°C temperaturbeständig und können auch Vibrationen aufnehmen.

Thermisch leitfähige Klebstofffilme und Gap-Filler

- bis 10 mm stark, vibrationsdämpfend
- thermische und mechanische Verbindung möglich
- dauerhaft temperaturbeständig bis 100°C bzw. 180°C
- als Rolle, Bogen oder Stanzteil

Die vorstehenden Angaben sind Herstellerangaben. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produkts zu prüfen, ob es sich im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Die SM Selbstklebetechnik übernimmt dabei keine Gewährleistung und Haftung.

Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl anderer Klebelösungen für verschiedenste Anforderungen, die Ihrem Unternehmen entscheidende Vorteile verschaffen können.

Unsere Fachberater informieren Sie gerne unverbindlich über unsere Lösungen, zum Beispiel für Elektronik, Logistik, kurz- und langfristige Kennzeichnung, elektrische Isolation oder Abdichtung.